

## TSE261-4U

TSE261-4U は、硬さ 32 の乳白色半透明、中引裂き性のミラブル型シリコンゴムです。

### 特長

- 作業性に優れています。
- 引裂強度が強く、力のかかる部品にも使用できます。

### 用途

- ダイヤフラム、ブーツ、ガスケット、O-リングなど、力のかかる部品に適しています。

### 一般特性

(JIS K 6249)

項目	特性値
外観	乳白色半透明
可塑度	180
標準加硫剤	TC-8 を 0.3 重量部*
一次加硫条件	170°C、10min
二次加硫条件	200°C、4h
密度 (23°C)	g/cm <sup>3</sup> 1.11
線収縮率	% 3.9
硬さ (タイプ A)	32
引張強さ	MPa {kgf/cm <sup>2</sup> } 8.9 {91}
切断時伸び	% 700
引裂強さ (アングル)	N/mm {kgf/cm} 22 {22}
圧縮永久ひずみ (180°C、22h) %	21
絶縁破壊の強さ	kV/mm 23
体積抵抗率	Ω · cm 2.0 × 10 <sup>15</sup>

\*コンパウンド 100 重量部に対して

### 耐熱性 (250°C、72h)

(JIS K 6249)

項目	特性値
硬さの変化	+2
引張強さの変化率	% -29
切断時伸びの変化率	% -31

## 使用方法

標準加硫剤 TC-8 を 0.3 重量部配合し、一次加硫(170°C、10min)、二次加硫(200°C、4h)を行います。

## 特許状況

本書のいかなる内容についても、関連特許が存在しないことを暗示したものと解釈してはならず、またいかなる特許についても、その権利者による許可なく、その特許が対象とする発明を実施するための許可、誘因または推奨を構成するものと解釈してはなりません。

## 製品の安全性、取り扱いおよび保管

製品の安全情報、安全な取扱手順、個人用保護具(必要な場合)、緊急サービスの連絡先情報、および安全な保管に必要な条件については、最新の安全データシート(SDS)および製品ラベルで確認してください。SDS は [www.momentive.com](http://www.momentive.com) で入手するか、あるいは MPM の担当者にご依頼ください。他の素材を MPM 製品(例:プライマー)と合わせて使用する際は、追加的な注意が必要になる場合があります。他の素材の製造者による安全情報を読み、それに従ってください。

## 制限

お客様はモメンティブ・パフォーマンス・マテリアルズ製品を評価し、特定の用途に対する使用適合性をご自身で判断する必要があります。

## お問い合わせ窓口

本製品に関するお問い合わせは下記までお願いします。

モメンティブ・パフォーマンス・マテリアルズ・ジャパン合同会社  
インサイドセールス:[Sales-JP.Silicones@momentive.com](mailto:Sales-JP.Silicones@momentive.com)

## 免責条項

モメンティブ・パフォーマンス・マテリアルズならびにその子会社および関係会社(以下、総称して「サプライヤー」といいます)の素材、製品およびサービスは、サプライヤーの標準販売条件に基づき販売されています。この標準販売条件は、該当する販売代理店契約または販売契約に含まれており、注文確認書や請求書の裏面に印刷され、また要求に応じて提供可能です。本書に記載の情報、推奨、または提言は、誠意をもって提供されていますが、サプライヤーは明示的にも黙示的にも、(i)本書に記載の結果が最終使用条件下でも得られること、および(ii)製品、素材、サービス、推奨または提言に取り入れられている設計の有効性もしくは安全性について、いかなる保証もいたしません。サプライヤーの標準販売条件に定めのあるものを除き、サプライヤーおよびその代理人は、本書に記載の素材、製品またはサービスの使用によって生じたいかなる損害に対しても責任を負わないものとします。サプライヤーの素材、サービス、推奨、または提言が、ユーザー自身の特定の使用目的に適しているか否かの判断については、各ユーザー自身が全面的に責任を負います。各ユーザーは、すべてのテストや分析を特定および実施して、サプライヤーの製品、素材、またはサービスが組み込まれている最終製品が安全であり、最終使用条件における使用に適していることを確認する必要があります。サプライヤーの署名入りの書面による合意がない限り、本書もしくはその他の文書または口頭による推奨または提言は、サプライヤーの標準販売条件の規定または本免責条項の変更、修正、優先、または権利放棄とはみなされないものとします。本書に含まれる素材、製品、サービスまたは設計の使用可能性または

使用提案に関するいかなる記載も、当該使用または設計を対象とするサプライヤーの特許その他の知的財産権に基づくライセンスを付与することを意図してはならず、あるいはライセンスの付与と解釈してはならず、また、何らかの特許その他の知的財産権を侵害する素材、製品、サービスまたは設計の使用の提案を意図してはならず、また使用提案として解釈してはなりません。

発行：2000年01月/改定②2022年01月/ Product Name